2016-2022年中国LED封装行业市场分析及投资前景评估报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制
www.chinairr.org

一、报告报价

《2016-2022年中国LED封装行业市场分析及投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201512/28-194472.html

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: http://www.chinairr.org

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

LED（发光二极管）封装是指发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。

报告目录：

第一章　LED封装相关概述17

1.1　LED封装简介17

1.1.1　LED封装作用17

1.1.2　LED封装的形式19

1.1.3　LED封装的结构类型20

1.1.4　LED封装的工艺流程20

1.1.5　LED封装对封装材料要求24

1.2　LED封装的常见要素24

1.2.1　LED引脚成形方法24

1.2.2　LED弯脚及切脚25

1.2.3　LED清洗25

1.2.4　LED过流保护28

1.2.5　LED焊接条件29

第二章　2014-2015年中国LED封装产业整体运营态势分析30

2.1　2014-2015年世界LED封装业的发展总况30

2.1.1　世界LED封装业发展规模及应用30

2.1.2　世界LED封装企业分析30

2.1.3　世界LED封装技术先进性分析31

2.2　2014-2015年中国LED封装业的发展综述31

2.2.1　中国LED封装业发展成果31

2.2.2　产值增长情况32

2.2.3　产量增长情况32

2.2.4　价格分析33

2.2.5　利好因素33

2.3　2014-2015年国内重要LED封装项目的建设进展33

2.3.1　韩企投资扬州兴建LED封装基地33
2.3.2　西安经开区LED封装线项目投产34
2.3.3　长治高科LED封装项目竣工投产34
2.3.4　敬亭园中园LED支架及封装项目开建35
2.3.5　源力光电LED封装线正式投产35
2.4　SMDLED封装36
2.4.1　SMDLED封装市场发展简况36
2.4.2　SMDLED封装技术壁垒较高38
2.4.3　SMDLED封装产能尚未过剩39
2.4.4　SMDLED封装受益于芯片价格下降42
2.5　2014-2015年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨43
2.5.1　制约我国LED封装业发展的因素43
2.5.2　国内LED封装企业面临的挑战45
2.5.3　封装业销售额与海外企业差距明显47
2.5.4　传统封装工艺成为系统成本瓶颈48
2.6　促进中国LED封装业发展的策略48
2.6.1　做大做强LED封装产业的对策48
2.6.2　发展LED封装行业的措施建议50
2.6.3　LED封装业发展需加大研发投入51
2.6.4　我国LED封装业应向高端转型51

第三章　2014-2015年中国LED封装市场新格局透析53
3.1　2014-2015年中国LED封装市场发展态势53
3.1.1　中国成中低端LED封装重要基地53
3.1.2　国内LED封装企业发展不平衡54
3.1.3　中国LED封装市场缺乏大型企业55
3.1.4　LED产业上游厂商涉足封装市场57
3.1.5　台湾LED封装产能向大陆转移57
3.2　中国LED封装企业分布状况58
3.2.1　2014年LED封装企业区域分布58
3.2.2　2015年LED封装企业区域分布59
3.3　广东省LED封装业63

3.3.1　主要特点63
3.3.2　重点市场64
3.3.3　发展趋势65

第四章　2014-2015年中国LED封装行业技术研发进展状况67
4.1　中外LED封装技术的差异67
4.1.1　封装生产及测试设备差异67
4.1.2　LED芯片差异67
4.1.3　封装辅助材料差异68
4.1.4　封装设计差异68
4.1.5　封装工艺差异69
4.1.6　LED器件性能差异70
4.2　中国LED封装技术发展概况71
4.2.1　封装技术影响LED产品可靠性71
4.2.2　中国LED业专利集中在封装领域72
4.2.3　中国LED封装业的技术特点73
4.2.4　LED封装技术水平不断提升73
4.2.5　LED封装业技术研发仍需加强73
4.3　LED封装关键技术介绍74
4.3.1　大功率LED封装的关键技术74
4.3.2　显示屏用LED封装的技术要求79
4.3.3　固态照明对LED封装的技术要求84

第五章　2014-2015年中国LED封装设备及封装材料的发展86
5.1　LED封装设备市场分析86
5.1.1　我国LED封装设备市场概况86
5.1.2　LED封装设备国产化亟需加速87
5.1.3　发展我国LED封装设备业的思路88
5.2　LED封装材料市场分析89
5.2.1　LED封装主要原材介绍89
5.2.2　我国LED封装材料市场简析89
5.2.3　部分关键封装原材料仍依赖进口90

5.2.4　LED封装用基板材料市场走向分析90
5.3　LED封装支架市场91
5.3.1　国内LED封装支架市场格局分析91
5.3.2　LED封装支架技术未来发展趋势91
5.3.3　我国LED封装支架市场前景广阔92

第六章　2014-2015年中国LED封装产业竞争新形态分析94
6.1　2014-2015年中国LED封装市场竞争格局94
6.1.1　中国采购影响世界封装市场格局94
6.1.2　我国LED封装市场各方力量简述94
6.1.3　国内LED封装市场竞争加剧95
6.1.4　本土LED封装企业整合步伐加速96
6.2　2014-2015年中国LED封装企业竞争力简析96
6.2.1　2014年本土封装企业竞争力排名96
6.2.2　2015年本土LED封装企业竞争力排名101
6.3　2016-2022年中国LED封装竞争趋势预测分析105

第七章　2014-2015年全球LED封装顶尖企业分析108
7.1　科锐（CREE）108
7.1.1　企业概况108
7.1.2　企业LED封装运营态势108
7.1.3　企业发展战略分析108
7.2　日亚化学（NICHIA）109
7.2.1　企业概况109
7.2.2　企业LED封装运营态势109
7.2.3　企业发展战略分析113
7.3　飞利浦（Philips）113
7.3.1　企业概况113
7.3.2　企业LED封装运营态势113
7.3.3　企业发展战略分析116
7.4　三星LED（SamsungLED）117
7.4.1　企业概况117

7.4.2　企业LED封装运营态势117
7.4.3　企业发展战略分析118
7.5　首尔半导体（SSC）119
7.5.1　企业概况119
7.5.2　企业LED封装运营态势119
7.5.3　企业发展战略分析120

第八章2014-2015年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析122
8.1　亿光电子122
8.1.1　企业概况122
8.1.2　企业LED封装运营态势122
8.1.3　企业发展战略分析124
8.2　光宝集团124
8.2.1　企业概况124
8.2.2　企业LED封装运营态势125
8.2.3　企业发展战略分析126
8.3　东贝光电127
8.3.1　企业概况127
8.3.2　企业LED封装运营态势128
8.3.3　企业发展战略分析129
8.4　宏齐科技129
8.4.1　企业概况129
8.4.2　企业LED封装运营态势130
8.4.3　企业发展战略分析130
8.5　台积电130
8.5.1　企业概况130
8.5.2　企业LED封装运营态势131
8.5.3　企业发展战略分析131
8.6　艾笛森134
8.6.1　企业概况134
8.6.2　企业LED封装运营态势134
8.6.3　企业发展战略分析135

第九章2014-2015年中国内地主要LED封装重点企业136
9.1　国星光电(002449)136
9.1.1　企业概况136
9.1.2　企业主要经济指标分析136
9.1.3　企业盈利能力分析138
9.1.4企业偿债能力分析139
9.1.5企业运营能力分析141
9.1.6企业成长能力分析144
9.2　雷曼光电144
9.1.1　企业概况144
（一）企业偿债能力分析145
（二）企业运营能力分析146
（三）企业盈利能力分析149
9.1.2　企业LED封装运营态势151
9.1.3　企业发展战略分析152
9.3　鸿利光电152
9.1.1　企业概况152
（一）企业偿债能力分析152
（二）企业运营能力分析154
（三）企业盈利能力分析157
9.1.2　企业LED封装运营态势159
9.1.3　企业发展战略分析159
9.4　大族光电（002008）159
9.4.1　企业概况159
9.4.2　企业主要经济指标分析160
9.4.3　企业盈利能力分析160
9.4.4企业偿债能力分析161
9.4.5企业运营能力分析163
9.4.6企业成长能力分析166
9.5　深圳市瑞丰光电子有限公司167
9.5.1　企业概况167

9.5.2　企业主要经济指标分析167
9.5.3　企业盈利能力分析167
9.5.4企业偿债能力分析169
9.5.5企业运营能力分析171
9.5.6企业成长能力分析174
9.6　宁波升谱光电半导体有限公司174
9.6.1　企业概况174
9.6.2　企业主要经济指标分析175
9.6.3　企业盈利能力分析175
9.6.4企业偿债能力分析176
9.6.5企业运营能力分析178
9.6.6企业成长能力分析181
9.7　南京汉德森科技股份有限公司182
9.7.1　企业概况182
9.7.2　企业主要经济指标分析182
9.7.3　企业盈利能力分析183
9.7.4企业偿债能力分析184
9.7.5企业运营能力分析186
9.7.6企业成长能力分析189

第十章　2016-2022年中国LED封装发展趋势及前景190
10.1　2016-2022年LED封装未来发展趋势190
10.1.1　功率型白光LED封装技术发展趋势190
10.1.2　LED封装技术将向模块化方向发展192
10.1.3　LED封装产业未来发展走向分析193
10.2　2016-2022年中国LED封装市场前景展望194
10.2.1　我国LED封装市场发展前景乐观194
10.2.2　LED封装产品应用市场将持续扩张194
10.2.3　中国LED通用照明封装市场规模预测195

第十一章　2016-2022年中国LED封装投资前景预测196
11.1　2016-2022年中国LED封装投资概况196

11.1.1　LED封装行业投资特性196
11.1.2　LED封装具有良好的投资价值200
11.1.3　LED封装投资环境利好200
11.2　2016-2022年中国LED封装投资机会分析201
11.2.1　LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）201
11.2.2　国家节能减排衍生LED封装投资机会202
11.3　2016-2022年中国LED封装投资风险及防范203
11.3.1　技术风险分析203
11.3.2　金融风险分析205
11.3.3　政策风险分析206
11.3.4　竞争风险分析207
11.4　专家建议208

图表目录：

图表12009-2015年台湾、大陆主要SMDLED企业产能对比37
图表22015年中国大陆SMDLED主要厂商的扩产情况40
图表32015年在大陆扩产的主要港台企业41
图表4国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响42
图表52014-2015年台湾前8大LED封装厂SMD产能及大陆业务57
图表62015年台湾在大陆投资的LED封装项目58
图表72014年全国LED封装企业区域分布58
图表82010中国LED封装企业竞争力排名101
图表9近3年佛山市国星光电股份有限公司销售毛利率变化情况138
图表10近3年佛山市国星光电股份有限公司资产负债率变化情况139
图表11近3年佛山市国星光电股份有限公司产权比率变化情况140
图表12近3年佛山市国星光电股份有限公司固定资产周转次数情况141
图表13近3年佛山市国星光电股份有限公司流动资产周转次数变化情况142
图表14近3年佛山市国星光电股份有限公司总资产周转次数变化情况143
图表15近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司资产负债率变化情况145
图表16近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司产权比率变化情况146
图表17近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司固定资产周转次数情况147
图表18近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况148

图表19近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司总资产周转次数变化情况149
图表20近3年深圳雷曼光电科技股份有限公司销售毛利率变化情况150
图表21近3年广州市鸿利光电股份有限公司资产负债率变化情况153
图表22近3年广州市鸿利光电股份有限公司产权比率变化情况154
图表23近3年广州市鸿利光电股份有限公司固定资产周转次数情况155
图表24近3年广州市鸿利光电股份有限公司流动资产周转次数变化情况156
图表25近3年广州市鸿利光电股份有限公司总资产周转次数变化情况157
图表26近3年广州市鸿利光电股份有限公司销售毛利率变化情况158
图表27近3年深圳市大族光电设备有限公司销售毛利率变化情况160
图表28近3年深圳市大族光电设备有限公司资产负债率变化情况162
图表29近3年深圳市大族光电设备有限公司产权比率变化情况162
图表30近3年深圳市大族光电设备有限公司固定资产周转次数情况163
图表31近3年深圳市大族光电设备有限公司流动资产周转次数变化情况164
图表32近3年深圳市大族光电设备有限公司总资产周转次数变化情况165
图表33近3年深圳市瑞丰光电子有限公司销售毛利率变化情况168
图表34近3年深圳市瑞丰光电子有限公司资产负债率变化情况169
图表35近3年深圳市瑞丰光电子有限公司产权比率变化情况170
图表36近3年深圳市瑞丰光电子有限公司固定资产周转次数情况171
图表37近3年深圳市瑞丰光电子有限公司流动资产周转次数变化情况172
图表38近3年深圳市瑞丰光电子有限公司总资产周转次数变化情况173
图表39近3年宁波升谱光电半导体有限公司销售毛利率变化情况175
图表40近3年宁波升谱光电半导体有限公司资产负债率变化情况177
图表41近3年宁波升谱光电半导体有限公司产权比率变化情况177
图表42近3年宁波升谱光电半导体有限公司固定资产周转次数情况178
图表43近3年宁波升谱光电半导体有限公司流动资产周转次数变化情况179
图表44近3年宁波升谱光电半导体有限公司总资产周转次数变化情况180
图表45近3年南京汉德森科技股份有限公司销售毛利率变化情况183
图表46近3年南京汉德森科技股份有限公司资产负债率变化情况184
图表47近3年南京汉德森科技股份有限公司产权比率变化情况185
图表48近3年南京汉德森科技股份有限公司固定资产周转次数情况186
图表49近3年南京汉德森科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况187
图表50近3年南京汉德森科技股份有限公司总资产周转次数变化情况188

详细请访问：http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201512/28-194472.html